

# 「國際產業人才教育專班」獎助金方案說明

因應產業人才需求，教育部配合國家發展委員會規劃，推動「國際產業人才教育專班」（簡稱**新型專班**），以企業需求為導向，提供獎助金，擴大招收國際學生。本獎助金方案整合政府及產業資源，由行政院國家發展基金提供產學獎助金，企業提供每位學生每月生活津貼（以下合稱獎助金），以及畢業後留臺就業機會。意者請詳閱以下說明，於期限內提出申請。

## 壹、申請辦法簡介

- (1) **申請資格**：國立臺灣大學 115 學年度碩/博士班入學之國際生、僑生、港澳生。已領取我國政府其他獎助學金者，不得重複申請。
- (2) **申請時間**：2026 年 4 月 15 日 17:00 (GMT+8) 止
- (3) **申請方式**：<https://forms.gle/TGBkMEzgBpVmVjev6>
- (4) **申請條件**：
  - 大學在學成績、畢業成績在班級排名或系排名中上程度。
  - 語言能力：
    - 參加中文授課班級者，華語文能力測驗 (TOCFL) 基礎級 (Level 2，相當於 CEFR A2) 聽、讀兩項皆須達 A2 級 (含) 以上。
    - 參加英文授課班級者，英文能力須達 CEFR B1 級 (含) 以上。
    - 符合臺大語言測驗免繳條件者無需額外提供語言能力證明。
- (5) **預定審核流程**：
  - 第一階段：合作企業資格審核 (2026 年 5~6 月)
  - 第二階段：教育部資格審核 (2026 年 6~7 月)

## 貳、權利義務

- (1) **獎助金補助項目**：獎助金至多領取兩年。
  - 初次來臺的相關必要行政費用：採一次性補助，包含來臺前的健康檢查費用、簽證費用及文書驗證費用，以地區分列補助上限為：歐美區域國家上限新臺幣 (以下同) 2 萬 5 千元、其他區域國家上限 1 萬元 (核實報支)。
  - 來臺單程機票：採一次性補助，機票費用以來臺最直接航程之經濟艙單程機票

核實請領，歐美區域國家上限 3 萬 5 千元、其他區域國家上限為 9 千元（核實報支）。

- 註冊入學後最多 2 年的學雜費。入學第二年參加中文授課班級者，華語文能力測驗（TOCFL）需達 B1 級（含）以上，參加英文授課班級者，華語文能力測驗（TOCFL）聽、讀兩項皆須達 A2 級（含）以上，且需通過學校與合作企業審查成績與表現。
- 每月生活津貼：金額依照各合作其業而定，第二年需通過學校與合作企業審查成績與表現後，方可繼續補助。

(2) **領取獎助金義務**：依據領取年限具有相應留臺至合作企業就業年限的義務。領取 1 年獎助金者，具有 1 年留臺就業義務，領取 2 年獎助金者，具有 2 年留臺就業義務。如中途因故未能完成學業或畢業後未履約就業，所受領之獎助金（包含政府獎助金與企業獎助金）繳還原則如下：

1. 屬不可歸責於學生之原因，無須繳還獎助金：

- 原合作企業因營運調整，於學生在學期間停止提供生活津貼，又學生經學校媒合仍無法覓得其他企業願意續予補助生活津貼者。
- 原合作企業因營運調整，於學生畢業時無職缺可聘用，又學生經學校進行就業輔導及媒合其他企業仍無法覓得適合企業聘僱者。
- 合作企業於學生就業期間有勞動基準法第十四條第一項規定情形，致學生提出終止契約，又學生經學校進行就業輔導及媒合，仍無法覓得適合企業接續聘僱者。
- 學生死亡、因重大疾病或意外事故不能繼續就學或就業，經衛生福利部新制醫院評鑑合格之教學醫院以上層級，開立認定無法繼續就學或就業證明者，或因事故致家庭巨變無法繼續就學或就業，經學校查證屬實者。

2. 屬可歸責於學生之原因，應繳還獎助金：

- 就學期間因個人因素中途退出專班，如申請轉學、轉系、休學返國，經學校輔導後仍放棄繼續就讀專班、或經學校依學則退學、開除學籍等情形，學生應全額返還已領之獎助金。
- 學生學習表現不佳，未通過學校及企業評核標準，並經學校輔導後仍無改善且依學則處以退學、開除學籍等情形，學生應全額返還已領之獎助金。
- 學生畢業後三個月內不至合作企業就業，並經學校輔導後仍無改善者，學生應全額返還已領之獎助金。
- 學生畢業就業後違反公司規定被依法終止勞動契約，並經學校輔導後仍無改善者，學生應依未就業之月數比例返還產學獎助金；不滿一月者，以一月計。
- 學生於合作企業就業期間未滿受領產學獎助金年限：應依其未就業之月數比例繳還產學獎助金；不滿一月者，以一月計。

## 參、合作企業

### (1) 專班系所與合作企業

臺大系所	碩士班合作企業
電機工程學研究所	華碩電腦股份有限公司 欣興電子股份有限公司 友達光電股份有限公司 和碩聯合科技股份有限公司 台灣國際航電股份有限公司 天鈺科技股份有限公司
資訊工程學系研究所	華碩電腦股份有限公司 台灣國際航電股份有限公司 天鈺科技股份有限公司
光電工程學研究所	華碩電腦股份有限公司 台灣國際航電股份有限公司
電子工程學研究所	群聯電子股份有限公司 台灣國際航電股份有限公司
電信工程學研究所	台灣國際航電股份有限公司
資訊網路與多媒體研究所	台灣國際航電股份有限公司
生醫電子與資訊學研究所	台灣國際航電股份有限公司
化學工程學系	欣興電子股份有限公司 長興材料工業股份有限公司
材料科學與工程學系	欣興電子股份有限公司 崇越科技股份有限公司
機械工程學系	和碩聯合科技股份有限公司 台灣國際航電股份有限公司
土木工程學系	崇越科技股份有限公司
環境工程學研究所	崇越科技股份有限公司
工業工程學研究所	台灣國際航電股份有限公司
化學系	長興材料工業股份有限公司
資訊管理學系暨研究所	華碩電腦股份有限公司
商學研究所	華碩電腦股份有限公司
會計學系暨研究所	國泰人壽保險股份有限公司
臺大系所	博士班合作企業
資訊工程學系研究所	和碩聯合科技股份有限公司

(2) 合作企業獎助金內容

合作企業	碩士班每月生活津貼	校外實習津貼	加碼補助
華碩電腦股份有限公司	1.5 萬元	實習期間提供依報到時議定的實習津貼	
群聯電子股份有限公司	1.5 萬元	實習期間每月提供 4 萬元的實習津貼	
欣興電子股份有限公司	1.5 萬元	實習期間每月提供 3.3~3.8 萬元的實習津貼	
友達光電股份有限公司	1.5 萬元	實習期間每月提供 4.2 萬元的實習津貼	就學期間獎金 4 萬元，報到獎金 20 萬
崇越科技股份有限公司	1.5 萬元	實習期間每月提供符合勞基法的實習津貼	
長興材料工業股份有限公司	1.5 萬元	無實習課程	
和碩聯合科技股份有限公司	1.5 萬元	無實習課程	
台灣國際航電股份有限公司	1.5 萬元	實習期間每月提供依職缺而定，高於基本工資的實習津貼	
天鈺科技股份有限公司	2 萬元	無實習課程	到職金 24 萬元
國泰人壽保險股份有限公司	1.5 萬元	實習期間提供每小時 210 元的實習津貼	
合作企業	博士班每月生活津貼	校外實習津貼	加碼補助
和碩聯合科技股份有限公司	2.5 萬元	無實習課程	

(3) 合作企業與提供職務簡介：學生通過學校及企業評核，完成學業取得學位後，合作企業具聘用權，應提供適合職缺及不低於同領域平均薪資之待遇，留用並聘僱學生。

合作企業	提供職務
華碩電腦股份有限公司 本公司主要營業項目為 3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板	軟韌體研發工程師 ● 設計與測試 ASUS 無線路由器嵌入式系統韌體

<p>及各類板卡、平板電腦及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設計與測試嵌入式系統應用程式</li> <li>● 設計與測試嵌入式系統通訊協定程式</li> </ul> <p><b>軟體研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 參與 AI 相關產品/服務的開發與設計</li> <li>● 進行 AI 模型的訓練與調優</li> <li>● 負責 AI 相關技術的研究與應用</li> <li>● 協助其他與 AI 相關工作</li> </ul> <p><b>Windows/MacOS 軟體研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責顯示器應用軟體研發</li> <li>● 分析與解決顯示器產品軟體/韌體/規格相關問題</li> <li>● 協助顯示器相關技術研究、產品與軟體創意發想</li> </ul> <p><b>硬體系統研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 從事商用系統產品的硬體設計及系統規劃</li> <li>● 設計電路及 Layout 佈局規劃</li> <li>● 與各相關單位合作解決系統電路之除錯、驗證、測試等</li> <li>● 協助工廠端生產</li> </ul> <p><b>SI/PI 工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責華碩產品(主機板、伺服器、桌機、筆電、手機、顯卡等)前期的系統級 SI/PI(訊號/電源完整度)模擬，並提供 EE 與 Layout 團隊電路板的設計建議</li> <li>● 執行 Pre-layout 模擬以評估適當疊構與 layout 設計</li> <li>● 執行 Post-layout 模擬以評估訊號與電源完整度</li> <li>● 進行先進電磁之相關議題研究</li> </ul> <p><b>EMC 研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定 3C 產品 (如筆記型電腦、智慧型手機、主機板、伺服器等…) 的 EMC (電磁相容) 設計指南，以確保華碩產品的最佳</li> </ul>
--	---

	<p>成本效益。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設計 EMC（電磁相容）及測試並通過相關法規認證</li> <li>● 設計靜電放電防護</li> <li>● 為同仁提供 EMC/認證的技術支援與訓練</li> <li>● 對 EMC 相關問題進行研究與討論</li> </ul> <p><b>RF 研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發 3C 產品（如：筆電、手錶、AIOT 等）中無線通訊的設計準則，以確保華碩產品最佳性價比</li> <li>● 深入研究產品中 RF /無線通訊較複雜問題，以找出最佳解決方案</li> <li>● 研究無線新技術之 RF 電路/系統設計，開發新功能或新應用</li> <li>● 申請專利或是發表國際期刊，保護產品競爭力</li> <li>● 為同仁提供無線通訊/RF 技術支援及訓練</li> </ul> <p><b>雲端暨自動化應用工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發雲端架構與實作系統，包含：架構設計，文件溝通撰寫，程式開發，測試，部署和監控...等工作</li> <li>● 重構與優化既有系統</li> <li>● 進行 Git 版本控制及與同仁間的 Code Review</li> <li>● 設計與整合系統，並與 RD 和 PM 單位共同協作</li> </ul> <p><b>軟韌體工程師(Router)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設計與開發 Wi-Fi 路由器韌體，著重性能優化與功能改善</li> <li>● 與硬體工程師合作，確保韌體相容性與發揮最大硬體效能</li> <li>● 實作網路協議與安全功能，確保穩健與安全的無線通訊</li> <li>● 韌體測試與除錯，確保產品穩定性與可靠性</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 收集、處理、分析 Wi-Fi 路由器的數據，以識別趨勢、使用行為、與性能指標</li> <li>● 與產品開發團隊密切合作，將數據見解轉化為可行的方式以改善產品</li> </ul> <p><b>App 軟體工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● App 軟體開發</li> <li>● 簡化內部開發流程，開發工具和自動化</li> </ul> <p><b>產品經理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責工控主板、系統或邊緣運算裝置等之產品規劃及管理</li> </ul>
<p><b>群聯電子股份有限公司</b></p> <p>營業項目：資料儲存媒體製造及複製業、光學儀器製造業、電子零組件製造業、資訊軟體服務業、資訊軟體零售業、電子材料批發業、電子材料零售業、產品設計業、國際貿易業。</p> <p>群聯電子於 2000 年成立於台灣，由開發全球首顆單晶片 USB 快閃記憶體隨身碟控制晶片起家。在接下來的 20 多年，群聯電子成為快閃記憶體控制晶片以及儲存解決方案的市場領導者，包含 PCIe / SATA / PATA 固態硬碟、UFS、eMMC、SD 到 USB 隨身碟等 NAND 儲存裝置。時至今日，全球出貨的固態硬碟中，近 1/4 皆是來自群聯的技術。</p>	<p><b>類比 IC 設計工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 類比/混合訊號 IC 設計及 SerDes, Adaptive Equalizer (CTLE/FFE/DFE), CDR, PLL, Transmitter, Receiver, RF , wide-band, high frequency amplifier, LNA, TIA, PA 的架構設計</li> <li>● DDR4/5 &amp; LPDDR4/5 PHY, flash(ONFi) PHY 的高速介面電路設計</li> <li>● PMIC, DC2DC converter, LDO 的電源類比電路設計</li> <li>● 各種功能類比 IP 電路設計，包括 ADC, PLL, DAC, GPIO, thermal sensor, etc.</li> </ul>
<p><b>欣興電子股份有限公司</b></p> <p>成立於 1990 年，是積體電路板 IC Carrier 及印刷電路板 PCB 的世界級供應商。創新與品質為欣興的競爭力來源，多年來持續突破技術並在全球快速擴張。</p>	<p><b>PCB 研發工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCB 板新產品技術開發含壓合/雷射/鑽孔/微影/電鍍製程</li> <li>● 製程進行時間與工作站別排程與取樣分析</li> <li>● 新材料、製程開發驗證與量產導入</li> <li>● 跨部門溝通合作</li> </ul> <p><b>Connector 產品設計工程師</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責 connector 產品設計</li> <li>● 了解客戶產品應用，提出 connector 設計方案</li> <li>● 新產品機械及電器性能分析並改良設計</li> <li>● 負責新產品開發、測試，認證並協助導入量產</li> </ul> <p><b>生產計劃工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中長期產能規劃模擬</li> <li>● 資源供需配對與整合</li> <li>● 跨部門會議召開與進度追蹤</li> <li>● 會 VBA, 資料庫 SQL 語法為佳</li> </ul>
<p><b>友達光電股份有限公司</b></p> <p>友達成立於 1996 年，全球員工超過 36,000 人，我們以世界領先的創新顯示技術與解決方案為基礎，正邁向多元垂直場域和產業應用，將面板應用於育樂、零售、醫療、移動、製造等智慧領域，展現領先全球的創新技術能量，持續將創新推至極致，更榮獲科睿維安 2023 全球百大創新機構。你可以和我們，一起在各種生活場域，創造人們前所未有的視覺體驗！加入友達，一起探索未來視界無限可能</p>	<p><b>電路設計工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設計與開發顯示面板(Micro LED/OLED/LCD)畫素電路及驅動方式</li> <li>● 進行光學模擬分析與驗證</li> <li>● 設計並模擬內嵌 TFT 周邊驅動電路</li> <li>● 量測電路電性、功耗與可靠度</li> </ul>
<p><b>崇越科技股份有限公司</b></p> <p>自 1990 年創立以來，在高科技專業領域均獲得高度成長及顧客的肯定。主要業務為代理銷售並服務客戶：包含高精密電子材料，儀器及設備；工業用純水／廢水處理設備；半導體、LCD 等之生產設備；積體電路、光纖通訊之光電材料；晶圓廠之製程系統，測試系統，無塵室系統等。除了代理全世界半導體三大廠之一的日本信越集團的半導體及光</p>	<p><b>半導體業務人員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 半導體相關專業知識</li> <li>● 市場行銷與開發</li> <li>● 產業及市場情報蒐集分析</li> </ul> <p><b>環境工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 參與專案執行</li> <li>● 水處理系統規劃設計監造試運轉</li> <li>● 工程品管作業</li> <li>● 控管工程進度、工程品質、勞工安全、工程成本</li> </ul>

<p>電產品，另與日本信越石英株式會社合資成立崇越石英股份有限公司，1995 年更與信越集團合資成立信越光電股份有限公司、台灣信越半導體股份有限公司，以提供國內高科技產業所需之原料。崇越科技目前擁有近六百家合作往來之廠商，自成立以來，營收屢創新高，經營團隊更持續開發新產品之代理銷售，適時擴充經營領域與營業規模，使各年度均維持大幅成長佳績。</p>	
<p><b>長興材料工業股份有限公司</b></p> <p>長興材料為 1964 年成立於台灣的股票上市公司，主要從事化學電子材料之研發、製造、加工及銷售。目前是全球最大乾膜光阻供應商，及全球前三大光固化材料供應商，且為亞洲最大合成樹脂供應商。發展 60 年至今，長興材料公司現已發展為全球近五千名員工的跨國集團，生產與銷售據點遍佈歐美、亞洲，產品行銷全球近 70 個國家。身為全球材料領導供應商，長興致力於技術開發與提升，並持續於全球重點市場努力深耕。</p> <p>加入長興材料，您將能於世界頂尖的材料產業中開拓多元的職涯發展。我們提供專業創意的空間，並重視工作與生活的平衡，期待與您一起共創未來。</p>	<p><b>研究員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 負責相關材料研究開發與配方設計</li> <li>● 研究相關實驗設計與執行</li> <li>● 文獻與專利資料蒐集與研讀</li> <li>● 產品現場試製、監製及製程檢討</li> <li>● 客戶端技術服務與相關客訴處理</li> <li>● 新原料調查研究、評估與測試</li> <li>● 產業相關資料調查與收集</li> <li>● 協助產品推廣與介紹</li> <li>● 因為業務需要至國內、外進行出差</li> <li>● 配合執行環境管理系統相關規定</li> <li>● 組織或單位主管其他交辦事項工作</li> </ul>
<p><b>和碩聯合科技股份有限公司</b></p> <p>和碩於 2008 年 1 月 1 日正式成立。秉持著豐厚的產品發展經驗及生產流程的垂直整合製造能力，致力提供客戶從創意設計到</p>	<p><b>機器人任務工程師</b></p> <p>主要職責：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設計和開發機器學習算法，提升機器人的任務執行能力</li> <li>● 開發和實施計算機視覺算法，用於物體識</li> </ul>

系統化的生產製造服務等一貫流程，完整、有效地滿足顧客的需求。和碩有堅強的研發陣容、親切與快速的服務品質，以及高度的員工向心力，並結合 EMS 與 ODM 產業，成為新興之 DMS（設計整合服務製造）企業，也因此能領先競爭者，提供最先進的產品，與有利的商機給我們的合作夥伴。

和碩傑出的產品服務包括電腦外型、硬體與機殼設計、可攜式設備、網通產品以及與運營和服務支援相關的周邊設備；電腦資訊技術和電腦編程諮詢；設計、更新、複製和維護電腦軟體並提供電腦和通信領域的擴展資訊服務，例如電腦系統分析、電腦網路系統分析、行動裝置通信傳輸等，滿足特定客戶需求。

此外，和碩還提供多樣化且可靠的客戶服務，包括為電腦相關產品、可攜式設備、行動裝置、家用電器、網路周邊設備等的安裝、維修與維護；根據客戶需求，提供為電信連接或網路傳輸資訊等有關的資訊、硬體和軟體服務。

營業項目：

- 電腦製造
- 未分類其他電力設備及配備製造
- 電腦及電腦週邊設備批發
- 其他未分類電子零組件製造

別、追蹤和環境感知

- 利用大模型技術（如 GPT-4）進行任務規劃和決策，確保機器人能夠自主完成複雜任務
- 控制機器人的姿態和機器手臂，實現精確的運動控制和任務執行
- 集成和調試感測器，如攝像頭、激光雷達（LiDAR）和深度感測器，提升機器人的環境感知能力
- 進行原型製作和測試，分析測試數據並進行設計改進
- 撰寫技術文檔，提供設計規範和測試報告
- 與跨功能團隊合作，確保系統的整體性能和可靠性

任職要求：

- 機械工程、電機工程、計算機科學或相關領域的學士或碩士學位
- 至少 3 年以上機器人任務控制或相關領域的工作經驗
- 熟悉機器學習算法，具備相關開發經驗
- 熟悉計算機視覺技術，包括物體識別、追蹤和環境感知
- 熟悉大模型技術，如 GPT-4，能夠應用於任務規劃和決策
- 熟悉機器人運動控制，包括姿態控制和機器手臂控制
- 具備良好的問題解決能力和團隊合作精神
- 具備良好的溝通能力，能夠撰寫技術文檔和報告
- ROS2 開發經驗：具備至少一年以上的 ROS2 環境開發經驗，能夠在 ROS2 平台上進行機器人應用開發和調試

優先考量：

- 具備機器人系統集成經驗，熟悉 EtherCAT、CAN、Modbus、RS485 或其他工業通訊協議
- 具備嵌入式系統開發經驗，熟悉 C/C++ 或其他編程語言

- 具備項目管理經驗，能夠獨立管理設計項目
- 生成式 AI 工具使用經驗：具備使用生成式 AI 工具（如 GPT-4、DALL-E）的經驗，能夠應用這些工具進行設計優化和創新
- 敏捷開發管理經驗：具備敏捷開發管理經驗，能夠應用敏捷方法論（如 Scrum、Kanban）來提高團隊的工作效率和項目交付質量
- 市場競爭產品與技術分析能力：具備分析市場競爭產品和技術的能力，能夠進行市場調研，並根據分析結果制定未來產品技術開發的規劃
- BSP 開發經驗：具備板級支持包（BSP）的開發經驗，能夠進行硬體抽象層的設計和實現
- Python 開發經驗：具備 Python 編程經驗，能夠使用 Python 進行測試自動化和數據分析

#### **機器人關節設計工程師**

主要職責：

- 設計和開發機器人關節模組，包括電機、減速機、剎車系統和感測器的集成
- 使用 CAD 軟體進行機械設計，並進行有限元素分析（FEA）以優化結構強度和剛度
- 開發和實施控制算法，如磁場導向控制（FOC）和矢量控制，確保關節的精確運動控制
- 與電氣工程師合作，設計和測試驅動電路和控制系統
- 進行原型製作和測試，分析測試數據並進行設計改進
- 撰寫技術文檔，提供設計規範和測試報告

任職要求：

- 機械工程、電機工程或相關領域的學士或

	<p><b>碩士學位</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 至少 3 年以上機器人關節設計或相關領域的工作經驗</li> <li>● 熟悉 CAD 軟體（如 SolidWorks、AutoCAD）和 FEA 工具（如 Ansys、COMSOL）</li> <li>● 具備電機設計和控制系統開發經驗，熟悉 PMSM 和 BLDC 馬達的設計和控制</li> <li>● 熟悉磁場導向控制（FOC）和矢量控制算法</li> <li>● 具備良好的問題解決能力和團隊合作精神</li> <li>● 具備良好的溝通能力，能夠撰寫技術文檔和報告</li> </ul> <p><b>優先考量：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具備機器人系統集成經驗，熟悉 EtherCAT、CAN、MODBUS、RS485 或其他工業通訊協議</li> <li>● 具備嵌入式系統開發經驗，熟悉 C/C++ 或其他編程語言</li> <li>● 具備項目管理經驗，能夠獨立管理設計項目</li> </ul> <p><b>AI 研究工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 理解利益相關者的業務目標並獲取需求</li> <li>● 將現實世界的問題轉化為相應的可求解抽象表示</li> <li>● 從各種來源收集、處理並清洗原始數據</li> <li>● 評估最新（SOTA）機器學習/深度學習算法的實用性，並使用真實數據實現相應方法</li> <li>● 跟蹤產品在現場的性能，並推動持續性能改進</li> <li>● 具備相關領域博士學位</li> </ul> <p><b>AI 數位孿生工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用 OpenUSD 和行業標準仿真工具開發高保真 3D 數字孿生</li> <li>● 為 AI 驅動的機器人和工業自動化設計並</li> </ul>
--	--

	<p>實現實時仿真環境</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用 ROS2、NVIDIA Omniverse 和 Isaac Sim 對機器人和自主系統進行仿真與測試</li> <li>● 將有限元分析 (FEA/FEM)、計算流體動力學 (CFD) 及基於物理的仿真集成到數字孿生中</li> <li>● 實現實時 IoT 數據流以及物理系統與虛擬系統之間的同步</li> <li>● 優化數字孿生在企業應用中的性能、可擴展性和精度</li> <li>● 與 AI/ML 工程師、軟件開發人員及領域專家合作，構建智能仿真環境</li> <li>● 具備相關領域博士學位</li> </ul>
<p>台灣國際航電股份有限公司</p>	<p><b>設備工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動化機構開發或治具設計經驗</li> <li>● 各類自動化元件應用</li> <li>● 機器手臂應用</li> <li>● 機電整合實作經驗</li> <li>● 熟悉 PLC 及微控制器</li> <li>● 電子電路設計與開發</li> <li>● 程式撰寫, C, C++, PLC ladder</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達 CEFR B1 級以上</li> </ul> <p><b>軟體工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 熟悉 C#、JAVA、Go 等語言</li> <li>● 具備機械手臂控制及系統整合相關實務經驗</li> <li>● 具備影像處理及 AOI 設備開發實務經驗</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達 CEFR B1 級以上</li> </ul> <p><b>量產製程工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準工時的建立與維護</li> <li>● 制訂製造程序與作業標準(SOP)</li> <li>● 持續產品與製程改善，提升生產效率與產能</li> </ul>

- 品質異常的問題解析與改善
- 生產人員的教育訓練
- 製造成本估算與分析
- 生產力分析與產量控管
- 協助專案導入與執行
- 減少浪費，降低生產成本
- 新產品的製程評估與導入
- 研究新製程及技術導入
- 跨廠區, 跨國境 產品承接或移轉，人員訓練，短期駐在或長期派遣。
- 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達達 CEFR B1 級以上

#### **工業工程師**

- 設施規劃暨生產系統設計
- 產能暨資源需求(人力與設備)計算、分析、規劃與控制/系統建置
- 製造成本分析
- 生產系統績效指標管理與分析
- 作業合理化與標準化(作業程序持續改善、整合與系統化、提升生產效率、減少浪費)
- 專題研究(跨部門/內部專案推行與改善)
- 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達達 CEFR B1 級以上

#### **軟體工程師(車載產品)**

- In-vehicle-infotainment(IVI) system development experience.
- Familiar with booting issues (ex. Booting performance / Quick Boot / Secure Boot)
- Familiar with Android/Linux OS
- Familiar with software version control system (ex. Git)
- Familiar with system performance

	<p>tuning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Familiar with I2C/SPI/SDIO/UART interfaces.</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達達 CEFR B1 級以上</li> </ul> <p><b>系統工程師(車載產品)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● JLPT N1 Certificate is requested. Familiar with : Automotive SPICE , ISO 26262</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、英文能力須達達 CEFR B1 級、JLPT N1 以上</li> </ul> <p><b>系統軟體驗證專案管理工程師(車載產品)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 具車用電子產品、3C 產品等系統軟體測試經驗佳。</li> <li>● 具備 Python / 自動化測試腳本 Automation test script 開發能力佳。</li> <li>● 具專案管理、客戶對應經驗者佳。</li> <li>● 良好的英文溝通及讀寫能力 (TOEIC 700 以上)。</li> <li>● 具問題分析與解決的能力 (熟悉 8D) 者佳。</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、TOEIC 800 以上</li> </ul> <p><b>軟體工程師 (嵌入式系統_健身產品)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 熟悉 C/C++ 程式設計</li> <li>● 健身 GPS 產品設計經驗：跑步穿戴裝置、自行車產品、健康產品</li> <li>● 良好的英文溝通能力，可與外籍工程師合作</li> <li>● 熟悉電腦架構；具 ARM Compiler 經驗佳</li> <li>● 有嵌入式系統或 RTOS 經驗佳</li> <li>● 具邏輯分析儀與 JTAG ICE 使用經驗佳</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熟悉作業系統相關知識佳</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、TOEIC 800 以上</li> </ul> <p><b>軟體測試工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 撰寫軟體功能的詳細測試計畫與測試案例</li> <li>● 評估整合韌體的產品，找出不足之處</li> <li>● 研究產品品質，提出改善方向，提升使用者體驗</li> <li>● 與亞洲及全球的研發團隊合作，進行測試規劃與執行</li> <li>● 與測試團隊合作開發自動化測試工具，以降低測試成本</li> <li>● 具軟體功能測試、GPS 測試、APP／Website 測試經驗佳</li> <li>● 熟悉 Python、Selenium、Appium 者佳</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、TOEIC 650 以上</li> </ul> <p><b>後端軟體工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 精通 Java (Spring Framework、SpringBoot) 或任一種物件導向語言。</li> <li>● 資料庫設計- 關聯式(Oracle/MS SQL/MySQL) 或 No SQL(Elasticsearch, HBase)。</li> <li>● 版本控制-Git 或 SVN。</li> <li>● 需與國外同事開會。</li> <li>● 樂於溝通，積極學習。</li> <li>● 加分-具備微服務架構開發經驗，熟悉 Docker, 分散式 messaging system (Kafka, RMQ), 分散式 caching system (Memcached, Redis)。</li> <li>● 語言能力：華語文能力測驗須達進階級 level 3、TOEIC 700 以上或同等英文能力</li> </ul>
天鈺科技股份有限公司	<p><b>數位電路設計工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 數位 IP, IC 設計</li> <li>● FPGA 驗證</li> </ul>

	<p><b>APR 工程師</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ASIC Backend / Physical Implementation including floorplan, power plan, placement, clock tree synthesis,</li> <li>● Routing, timing analysis.</li> <li>● Responsible for physical verification, including DRC, LVS, IR drop analysis.</li> </ul>
<p><b>國泰人壽保險股份有限公司</b></p> <p>國泰人壽目前客戶數約八百萬人，有效契約件數超過一千九百萬件，為全台灣最大之保險公司。我們遵循「誠信、當責、創新」的集團核心價值，持續在保險本業與社會公益持續努力，同時將堅持走在資訊應用發展的尖端，運用新興科技力量驅動創新變革風潮，未來也將繼續以絕對的努力成就業界典範，並朝成為『亞太地區最佳金融機構』的願景邁進。主要商品/服務項目：辦理壽險保障、健康醫療、意外傷害、投資型商品、微型保險等保險業務。</p>	<p><b>資訊部財務規劃人員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解資訊處預算編列作業，並支援相關作業。</li> <li>● 優化不同類型預算科目作業流程。</li> <li>● 職務所需專業能力：會計、財務專業</li> <li>● 職務所需語言能力：華語文能力測驗須達精通等級、英文能力須達流利等級</li> </ul>

## 肆、其他

### (1) 其他說明：

- 部分合作企業要求以視訊面試方式審核獎助金資格，如有需要將以 Email 通知並安排視訊面試。
- 最終結果以教育部審核結果為準。
- 獎助金必須於臺大完成註冊報到，並與合作企業簽約完畢後開始發放。
- 如獎助金方案有變動，將依教育部公告以及合作企業合約內容為準。

### (2) 聯絡人：臺大國際產學聯盟，沈小姐，電話:+886-2-3366-6303，Email: [allyshen@ntu.edu.tw](mailto:allyshen@ntu.edu.tw)